TECHNICAL
DATA SHEET

NITTO DENKO
日東電工株式会社
エレクトロニクス事業部門
半導体材料事業部

セルフリリース型トランスファー成型用透明封止樹脂
NT-３００Hシリーズ取扱説明書

この度は NT-300 シリーズのご評価、ご使用戴きまして、誠に有り難う御座います。NT-300 は、業界初のセルフリリース型のトランスファー成形用透明樹脂です。この NT-300 シリーズの特徴を十分に発揮させる為の、取扱い方法、封止条件と成形金型作成時の要望について下記させて戴きます。記載内容を十分にご理解戴きました後に、ご検討、ご使用賜りますようにお願い申し上げます。

1　取り扱い

1)保　管　：

５℃以下の冷暗所に、保管下さい。

2)ご使用に際して

a．５℃以下の冷暗所から取出し常温に２４時間放置後、開封して下さい。

b．開封したタブレットは、２５℃３０％以下のドライボックス中に保管して下さい。

－－ドライボックス中は、乾燥空気又は窒素で＋圧に保持して下さい。－－

c．常温に戻したタブレットは、２４時間以内にご使用下さい。

以上の a.- c.項は、吸湿によるタブレットの特性変化を抑制する為の事項です。

2　成型に際して

1)金型のコンディショニング方法

a．クリーニング樹脂(メラミン系が主)又は、クリーニングシートを用いて、金型面をクリーニングして下さい。

b．クリーニング後、下記の方法で金型表面のコンディションを整えて下さい。

* コンディショニング樹脂(弊社製品名：KNJ-3)を１－２ショット、または
* シリコーン系外部離型剤を塗布

c．次に、ダミーショットを２－３ショット行った後に、本成形を行って下さい。

Copyright © 2001 日東電工株式会社

注意）この文書に係る知的所有権は日東電工(株)にあります。弊社の意図する正当な使用目的以外にこの文書を使用される場合は、事前に御相談くださるようお願いいたします。弊社に無断の複写、転載は固くお断りいたします。

2)成形条件

表－１の成形条件に、金型を整えて下さい。

a. 射出時間、プレヒート温度については、実験計画法などを用いて、最適範囲をご確認下さい。
b. 型開き及び、イジェクト速度は、必ず尊守下さい。（型開き後、下型５mm下降位置迄の速度です。）
c. プランジャーヒーターを出来れば、取付けて下さい。

表－１：成形条件

調整項目	単位	推奨範囲
金型温度	℃	155－163
型締圧力	MPa	20 (204kgf／cm^2)
射出圧力	MPa	3－8 (31～82kgf／cm^2)
射出時間	s	20－50
プレヒート温度	℃	60－80
型開き速度	mm/s	0.5以下
イジェクト速度	mm/s	0.5以下
(プランジャー温度)	℃	165－170

3 金型の設計に際して

a. E-pin を、キャビティー内にも設けて下さい。フレームイジェクトは好ましく有りません。
b. ランナー部での E-pin の間隔は、２０－２５mm間隔で設けて下さい。
c. 気泡などの成形不良低減の為に、ゲート及びエアーベントのサイズや位置などキャビティー設計についても適正化を図って下さい。

* 気泡低減の為に、真空成形をお勧めします。

Copyright © 2001 日東電工株式会社